

2012年1月30日

報道各位

住友金属鉱山株式会社

材料事業の構造転換に向けた諸施策の実施について

住友金属鉱山株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 家守伸正）は、2009年中
期経営計画における材料事業部門の基本戦略である事業構造の転換に向けて、成長をめざ
す事業を明確にするとともに、中・長期的に展望を描けない事業については、売却または
撤退する「選択と集中」の検討を進めてきたところです。

これに向けて当社は、今後成長が見込まれる環境・エネルギー分野向け材料の拡大、強
化を図る一方、将来の成長戦略を描けないボンディングワイヤー事業、タイにおけるリー
ドフレーム生産ならびに台湾におけるサブトラクティブ Chip On Film（以下、COF）生
産について、これら事業から撤退することを決定しました。

今後は、これらに投下していた経営資源を電池材料やサファイア基板などの環境・エネ
ルギー分野向けの材料事業等に振り向けることとします。

1) ボンディングワイヤー事業

ボンディングワイヤーは、近年の価格競争の激化から収益の低下が著しく、また金価
格の高騰などを背景として、市場構造が金線から銅線へ急速に移行しており、その動き
は今後さらに加速するものと予想されます。このような市場の転換に対して、当社は銅
線開発・量産化体制づくりを進めてきましたが、将来の成長に向けた道筋が描ききれな
いことから、ここを節目として2012年6月を目途にボンディングワイヤーの生産を終
了し、本事業から撤退することとしました。

なお、本事業撤退に伴い撤退関連損失約30億円が発生する見込みであり、2012年3
月期決算において引当金を計上する予定です。本件は2011年11月8日に公表した連結
業績予想には含まれておりません。

2) タイにおけるリードフレームの生産

2011年10月に発生したタイの大規模洪水により、操業停止を余儀なくされた
Sumiko Leadframe(Thailand) Co.,Ltd.については、同年11月末に水没が解消した後、
生産再開に向けての復旧を検討しておりました。しかしながら、冠水期間が1ヵ月を超
え、生産再開のためには長期の日数を要するとともに、同社で生産していたリードフレ
ーム製品については、当社グループの他の生産拠点での代替が可能であるとの見通しが
立つに至りました。従って、同社の復旧・生産再開は行わず、同社でのリードフレーム
事業から撤退することとしました。

なお、今回のタイでの大規模洪水による損害および撤退費用については、2011年11

月 8 日に公表した連結業績予想に織り込んだ水没設備の簿価相当額を含め 20 億円程度となるものと想定しており、2012 年 3 月期決算において計上および引当金を繰り入れる予定です。

3) 台湾におけるサブトラクティブ COF 生産

当社グループの台湾住鋁電子股份有限公司で生産している COF については、主要な需要がより高精細なものへと移行しており、現状はサブトラクティブ・プロセスで可能な高精細品製造の限界を超える状況にあります。今後、本方式で生産可能な COF の需要は一層縮小すると見込まれるとともに、供給過剰による価格下落も著しいことからサブトラクティブ・プロセス品種は、成長性・経済性が見込めないと判断し、ここを節目として 2012 年 6 月を目途に生産を終了し、撤退することとしました。

今後の COF 事業については、既に同社で稼動しておりますセミアディティブ・プロセスにて生産する超高精細品種に集中して事業展開を行なっております。

なお、本件に伴い撤退関連損失約 30 億円が発生する見込みであり、2012 年 3 月期決算において計上および引当金を繰り入れる予定です。本件については 2011 年 11 月 8 日に公表した連結業績予想には含まれておりません。

【ご参考】

(各社の概要)

①ボンディングワイヤー関係

住友金属鋁山株式会社半導体材料事業部（販売会社）

大口電子株式会社（製造会社）

所在地 鹿児島県伊佐市

資本金 10 億円（住友金属鋁山株100%出資）

事業内容 リードフレーム、ボンディングワイヤー、非鉄金属の回収・リサイクル、機能性インク、サファイア基板

台住電子材料股份有限公司（製造会社）

所在地 台湾 高雄市

資本金 75,800 千 TWD（住友金属鋁山株グループ 100%出資）

事業内容 ボンディングワイヤー、薄膜材料

Malaysian Electronics Materials SDN.BHD.（製造・販売会社）

所在地 マレーシア セランゴール州

資本金 10,000 千 MYR（住友金属鋁山株100%出資）

事業内容 ボンディングワイヤー、厚膜材料

上海住友金属鉱山電子材料有限公司（製造・販売会社）

所在地 中華人民共和国 上海市

資本金 50,746 千 RMB（住友金属鉱山(株)グループ 100%出資）

事業内容 ボンディングワイヤー

②リードフレーム関係

Sumiko Leadframe(Thailand) Co.,Ltd.

所在地 タイ国 アユタヤ県

資本金 360,000 千 THB（住友金属鉱山グループ 100%出資）

事業内容 リードフレーム

③COF関係

台湾住友金属電子股份有限公司

所在地 台湾 高雄市

資本金 1,110,000 千 TWD（住友金属鉱山(株)グループ 70%出資）

事業内容 リードフレーム、COF

(用語説明)

ボンディングワイヤー

IC（集積回路）の電極とリードフレームを結ぶための導電線

COF

液晶駆動用ICと液晶パネルをつなぐための配線を施したテープ材料

サブトラクティブ・プロセス

銅めっきを施したポリイミド基板へエッチング方式により配線を形成する方法

セミアディティブ・プロセス

ポリイミド基板へ銅めっきを積上げる方式により配線を形成する方法

(本件に関するお問い合わせ先)

広報 IR 部 青野 祥紀

TEL : 03-3436-7705

FAX : 03-3434-2215

以 上